

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
31. Oktober 2002 (31.10.2002)

PCT

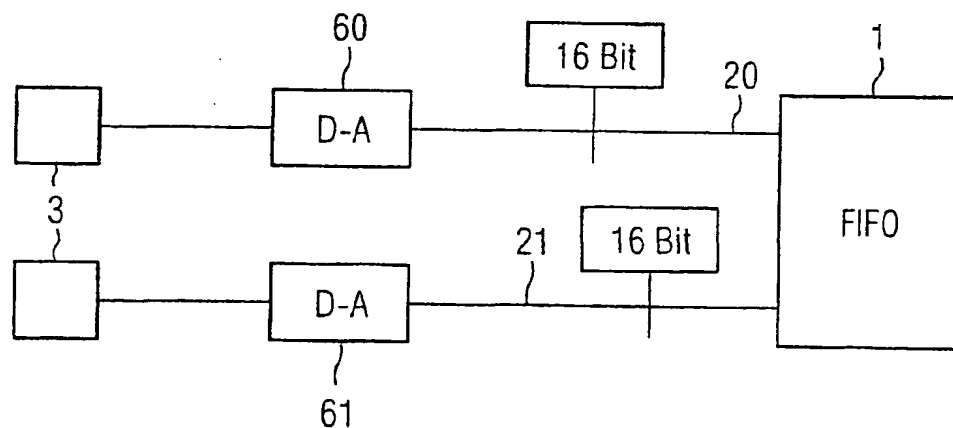
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 02/086903 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: G11C 7/16 (72) Erfinder; und  
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE02/01504 (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): OBERGRUSS-  
(22) Internationales Anmeldedatum: 24. April 2002 (24.04.2002) BERGER, Franz-Xaver [DE/DE]; Hochstrasse 16, 84568  
Pleiskirchen (DE). BAENISCH, Andreas [DE/DE]; An-  
nette-Kolb-Anger 13, 81737 München (DE). ZIMMER-  
MANN, Ellen [DE/DE]; Kaltenbrunnerstrasse 7, 85653  
Aying (DE).  
(25) Einreichungssprache: Deutsch  
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (74) Anwalt: EPPING, HERMANN & FISCHER; Ridler-  
strasse 55, 80339 München (DE).  
(30) Angaben zur Priorität: 101 20 054.4 24. April 2001 (24.04.2001) DE (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, KR, US.  
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-  
Martin-Strasse 53, 81669 München (DE). Veröffentlicht:  
— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu  
veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SEMICONDUCTOR MEMORY ELEMENT

(54) Bezeichnung: HALBLEITERSPEICHERBAUELEMENT



(57) Abstract: According to the invention, a plurality of digital-analogue converters (60, 61) and analogue-digital converters are positioned in the data lines (20, 21) between the connection contacts (3) and the memory cells (1), in such a way that the reading, writing and control of the memory takes place by analogue data transfers instead of the previous digital signatures. It is therefore possible to read, by means of a single connection contact, the same quantity of data, which would usually necessitate several connection contact surfaces (pads). Respective contact surfaces for the analogue line address and the analogue column address are sufficient for addressing the memory cells, said addresses being converted into digital addresses using analogue-digital converters.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 02/086903 A2